

29/01/03
2003002698

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 2 月 14 日 (14.02.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/12619 A1

(51) 国際特許分類⁷: D21H 13/26, D04H 1/42, H05K 1/03

帝人株式会社 大阪研究センター内 Osaka (JP). 石原
繁 (ISHIHARA, Shigeru) [JP/JP]; 〒791-8041 愛媛
県松山市北吉田町77番地 帝人株式会社 松山事業所
内 Ehime (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05259

(22) 国際出願日: 2000 年 8 月 4 日 (04.08.2000)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(74) 代理人: 前田純博(MAEDA, Sumihiro); 〒100-0011 東
京都千代田区内幸町2丁目1番1号 帝人株式会社 知的
財産センター内 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 帝人株
式会社 (TEIJIN LIMITED) [JP/JP]; 〒541-0054 大阪府
大阪市中央区南本町1丁目6番7号 Osaka (JP).

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 村山定光
(MURAYAMA, Sadamitsu) [JP/JP]. 松井亨景 (MAT-
SUI, Michikage) [JP/JP]. 和田正典 (WADA, Masanori)
[JP/JP]; 〒567-0006 大阪府茨木市耳原3丁目4番1号

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。



162162



ACTION

(54) Title: HEAT-RESISTANT FIBROUS PAPER

WO 02/12619 A1

(54) 発明の名称: 耐熱性繊維紙

(57) Abstract: A heat-resistant fibrous paper which is formed mainly from short fibers made of a heat-resistant organic polymer, short fibers made of an unstretched or lowly stretched para-aromatic polyamide, and an organic resin binder and/or fibrils made of a heat-resistant organic polymer, wherein the amount of the short fibers is 45 to 97 wt.% based on the whole paper, the amount of the organic resin binder and/or the fibrils is 3 to 55 wt.%, and the organic resin binder has been cured and/or the short fibers of an unstretched or lowly stretched para-aromatic polyamide and the fibrils were partly softened and/or deformed and melted to make them serve as a binder. This heat-resistant fibrous paper is excellent in heat resistance, thermal dimensional stability, interlaminar peel strength, electrical insulating properties in a high-humidity atmosphere, etc. and can be satisfactorily impregnated with a resin despite its high bulk density. It is especially suitable for use as a substrate for electrical insulating materials or a substrate for layered products for electrical circuits.

[続葉有]